

TPX离型膜规格书

一、产品特点			
1、本产品为日本三井TPX无硅离型膜，全部为千级无尘车间生产和分切，100%无硅油转移的现象。			
2、有FPC产品PI补强、钢片、FR4补强、电磁膜、覆盖膜等隔离和离型的作用			
3、最高耐温190℃，压合预压时间：5-15S，成型时间：60-180S。			
二、产品应用			
使用在FPC产品的压合和组装工序，适用于PI补强、钢片、FR4补强、电磁膜、覆盖膜等产品的压合成型工艺。有无硅和填充性好的特点和优势。			
三、产品结构			
		TPX基材厚度50、100、120um	
四、物性标准			
特性	检查项目	单位	管控规格范围
物理性质	基材总厚度	um	50、100、120um
	颜色	/	透明/乳白色
	宽度	mm	按客户规格值±1mm
	拉伸强度	Mpa	MD: 125 / TD: 12
	热收缩率	%	MD: 0.5/ TD: -0.03
	涂布层厚度	um	无
	离型力	g	TPX原膜
	残余率(%)	%	99%
	耐热性	/	160℃/5min, 无溶化
外观检验	脏污杂质	/	目视不可见
	晶点	/	目视不可见
	不离型	/	不允许
	接头	/	每批次允许2卷或与客户协商
五、保存环境			
室内环境20±5℃，湿度45-75%，避免阳光直射，未拆包装可保存12个月。拆包装后保存期限为3个月。			
六、注意事项			
1、以上数据仅供参考，各生产厂家工艺参数和条件不同，请自行测试其适用性；			
2、离型膜表面在涂布工艺的特殊性，客户使用过程中禁止与化学溶剂直接接触。			